

三安光电股份有限公司
二〇二三年第二次临时股东大会会议资料

2023年6月26日

三安光电股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、**会议召开方式：**现场投票和网络投票相结合

二、**网络投票时间：**2023 年 6 月 26 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、**现场会议召开时间：**2023 年 6 月 26 日 14 点 30 分

四、**现场会议召开地点：**厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室

五、会议议程

(一) 会议主持人宣布现场会议开始；

(二) 会议审议的议案：

1、审议公司全资子公司与意法半导体签署《合资协议》的议案；

2、审议公司全资子公司对外投资的议案。

(三) 股东发言；

(四) 选举现场会议监票人、计票人；

(五) 宣布现场会议到会情况；

(六) 现场会议对议案进行表决；

(七) 计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；

(八) 上传现场表决结果与网络投票汇总；

(九) 主持人宣读会议表决结果；

(十) 律师宣读法律意见书；

(十一) 主持人宣布会议结束。

一、审议公司全资子公司与意法半导体 签署《合资协议》的议案

各位股东及授权代表：

STMicroelectronics International N.V.（以下简称“ST International”）与意法半导体（中国）投资有限公司（以下简称“意法半导体”）均为 STMicroelectronics N.V.（在美国上市交易）全资子公司。鉴于 ST International 与湖南三安半导体有限责任公司（以下简称“湖南三安”）有意在中国重庆市设立一家专门从事碳化硅外延、芯片生产的合资代工公司，制造碳化硅外延、芯片并独家销售给 ST International（或 ST International 指定的任何实体）；湖南三安或其指定方将为该合资公司供应衬底并签署衬底供应协议，本公司（或经意法半导体同意的湖南三安的其他关联公司）承诺，保证湖南三安遵照合资协议和衬底供应协议履约；合资公司将与湖南三安签订长期碳化硅衬底供应协议，以保证合资公司未来材料的工艺需求。

根据本公司发展战略，经本公司董事会研究，同意湖南三安与意法半导体签署《合资协议》，双方将在重庆市设立合资公司-三安意法半导体（重庆）有限公司（暂定名，最终以有权机关核准为准），预计投入总金额为 32 亿美元，将根据合资公司进度需要陆续投入。该合资公司的注册资本为 6.12 亿美元，湖南三安持股比例为 51%，意法半导体持股比例为 49%，均以货币资金分期出资，主要从事碳化硅外延、芯片生产。该项目在取得各项手续批复后开始建设，2025 年完成阶段性建设并逐步投产，规划 2028 年达产后生产 8 吋碳化硅晶圆 10,000 片/周。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日公告刊登在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公司关于全资子公司签署《合资协议》暨成立合资公司的公告。

特此报告，请审议表决。

二、审议公司全资子公司对外投资的议案

各位股东及授权代表：

鉴于湖南三安半导体有限责任公司（以下简称“湖南三安”）与意法半导体（中国）投资有限公司（以下简称“意法半导体”）签署《合资协议》，湖南三安（或其指定方）将为该合资公司供应衬底并签署衬底供应协议，本公司（或湖南三安的其他关联公司）承诺，保证湖南三安遵照合资协议和衬底供应协议履约。经本公司董事会研究，同意湖南三安在重庆设立全资子公司重庆三安半导体有限责任公司，预计投资总额 70 亿元人民币，将根据合资公司的进度陆续投入。该项目注册资本为 18 亿元人民币，湖南三安以自有资金分期缴纳出资，首期出资 5-10 亿元人民币，主要从事生产碳化硅衬底，达产后，规划生产 8 吋碳化硅衬底 48 万片/年。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日公告刊登在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公司关于全资子公司对外投资的公告。

特此报告，请审议表决。